



asicland

Investor Relations 2024

A Promising Journey to Silicon Success

ASICLAND

INDEX 001

* PFL 0-100
* PFL 0-100
* PFL 0-100
* PFL 0-100

+ NAT 0-100
+ NAT 0-100
+ NAT 0-100
+ NAT 0-100

PROBLEMA 0002 001

Disclaimer

본 자료는 Presentation에서의 정보 제공을 목적으로 에이직랜드 이하 “회사”에 의해 작성되었습니다.

본 자료에 포함된 “예측정보”는 개별 확인 절차를 거치지 않은 정보들입니다. 이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 사항으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미하고, 표현상으로는 ‘예상’, ‘전망’, ‘계획’, ‘기대’, ‘(E)’ 등과 같은 단어를 포함합니다.

위 “예측정보”는 향후 경영환경의 변화 등에 따라 영향을 받으며, 본질적으로 불확실성을 내포하고 있는 바, 이러한 불확실성으로 인하여 실제 미래 실적은 “예측정보”에 기재되거나 암시된 내용과 중대한 차이가 발생할 수 있습니다.

또한, 향후 전망은 Presentation 실시일 현재를 기준으로 작성된 것이며, 현재 시장상황과 회사의 경영방향 등을 고려한 것으로, 향후 시장환경의 변화와 전략수정 등에 따라 별도의 고지 없이 변경될 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

본 자료의 활용과 관련하여 발생하는 손실에 대하여 회사 및 회사의 임직원들은 과실 및 기타의 경우 포함하여 그 어떠한 책임도 부담하지 않음을 알려드립니다. 본 문서는 주식의 모집 또는 매출, 매매 및 청약을 위한 권유를 구성하지 아니하며 문서의 그 어느 부분도 관련 계약 및 약정 또는 투자 결정을 위한 기초 또는 근거가 될 수 없음을 알려드립니다.

본 자료는 비영리 목적으로 내용 변경 없이 사용이 가능하고(단, 출처표시 필수), 회사의 사전 승인 없이 내용이 변경된 자료의 무단 배포 및 복제는 법적인 제재를 받을 수 있음을 유념해 주시기 바랍니다.

Corporate Identity



01. 국내 유일 TSMC VCA

- 글로벌 파운드리 No.1 TSMC의 생태계 핵심인 VCA로서 디자인솔루션내 독보적 위치
- TSMC의 VCA로서 높은 공정 이해도 기반 Spec-In부터 턴키 솔루션 제공



02. Arm의 ADP 공식 파트너

- 글로벌 최대 IP 기업 Arm의 지정 공식 파트너로서 글로벌 메이저 파트너들과 동반 성장
- Arm Total Design' 프로그램 파트너로 선정



03. ASIC 설계 자동화 플랫폼 보유

- 독보적인 SoC 설계 자동화 플랫폼 보유 (AWorld Magic™)
- 백엔드 설계 자동화 플랫폼 보유 (ALPS™)
- Si 기반 백엔드 하드닝 솔루션 보유



04. 독보적인 ASIC 설계 역량 보유

- TSMC공정(1,000nm~3nm) 다양한 레퍼런스 보유
- 국내 최초 고대역대 기지국용 5G RF칩 개발 및 양산
- 국내 최초 서버용, 엣지용 Si반도체 개발



글로벌 ASIC 디자인 솔루션 대표기업



asicland

05. 스케일업 선순환 수익 모델 구축

- 개발 후 양산으로 이어지는 스케일업 선순환 고리 장착
- 우량한 양산 파이프라인 보유 (2023.12 기준)
 - 개발중인 프로젝트 57건
 - 개발 수주 잔고 1,049억 원



06. 우량한 경영 성과

- 2개년 CAGR 72%의 매출 성장(2020~2022)
- 영업 이익 YoY 316% 성장(2021~2022)



07. 지속적인 성장 동력 장착

- 10년 이상 된 설계 베테랑 엔지니어의 높은 비중
- 스타트업부터 대기업까지 다양한 고객사 확보 (약 70社)
- 4차산업 가속화에 따른 애플리케이션 전방위 확대



08. 신사업 진출 가속화

- 미국 시장 진출을 통한 신규 고객사 확보
- IP 비즈니스 확대



01

Business Overview

01. 회사개요
02. 성장 히스토리
03. 비즈니스 영역
04. Top Level R&D
05. ASIC 설계 자동화 플랫폼 구축
06. 경영성과

SoC

SoC 사업부는 Spec-in부터 칩 설계 및 개발보드, F/W, OS포팅까지 개발 전반에 걸쳐 고객이 필요로 하는 부분에 대하여 서비스를 제공합니다.



01. 회사개요



글로벌 ASIC 디자인솔루션 대표기업, 에이직랜드

일반 현황

이종민

대표이사

“글로벌 No.1 디자인 솔루션 기업으로”

- 2003 SK하이닉스 반도체 연구원
- 2005 주버추얼다임 책임연구원 : SOC개발팀
- 2009 주휴먼칩스 수석연구원 : ASIC개발팀
- 2012 주다윈텍 수석연구원 : ASIC개발팀
- 2016 주에이직랜드 대표이사

회사명	(주)에이직랜드
대표이사	이종민
설립일	2016년 4월 5일
자본금	53.4억원
임직원수	190명 (24년 02월 말 기준)
주요사업	주문형 반도체 디자인 서비스, 시스템 온 칩 제품 개발
주소	경기도 수원시 영통구 대학로 60, 309호(리치프라자 3차)
홈페이지	http://www.asicland.com

자료 : 당사 내부자료

회사조직 구성



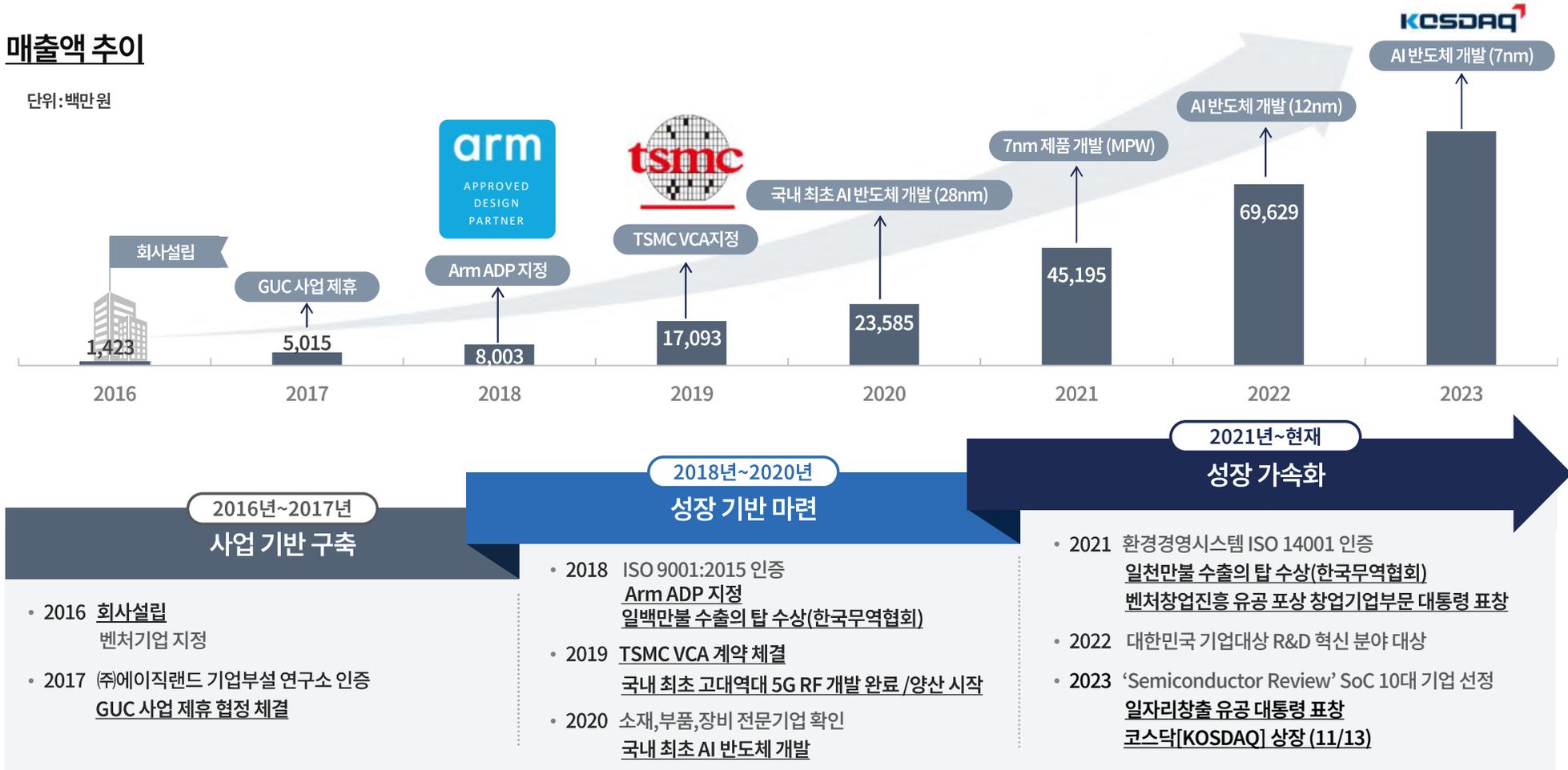
02. 성장 히스토리



10년 이상의 베테랑 설계 엔지니어 기반 글로벌 ASIC 디자인 솔루션 기업으로 성장

매출액 추이

단위:백만원



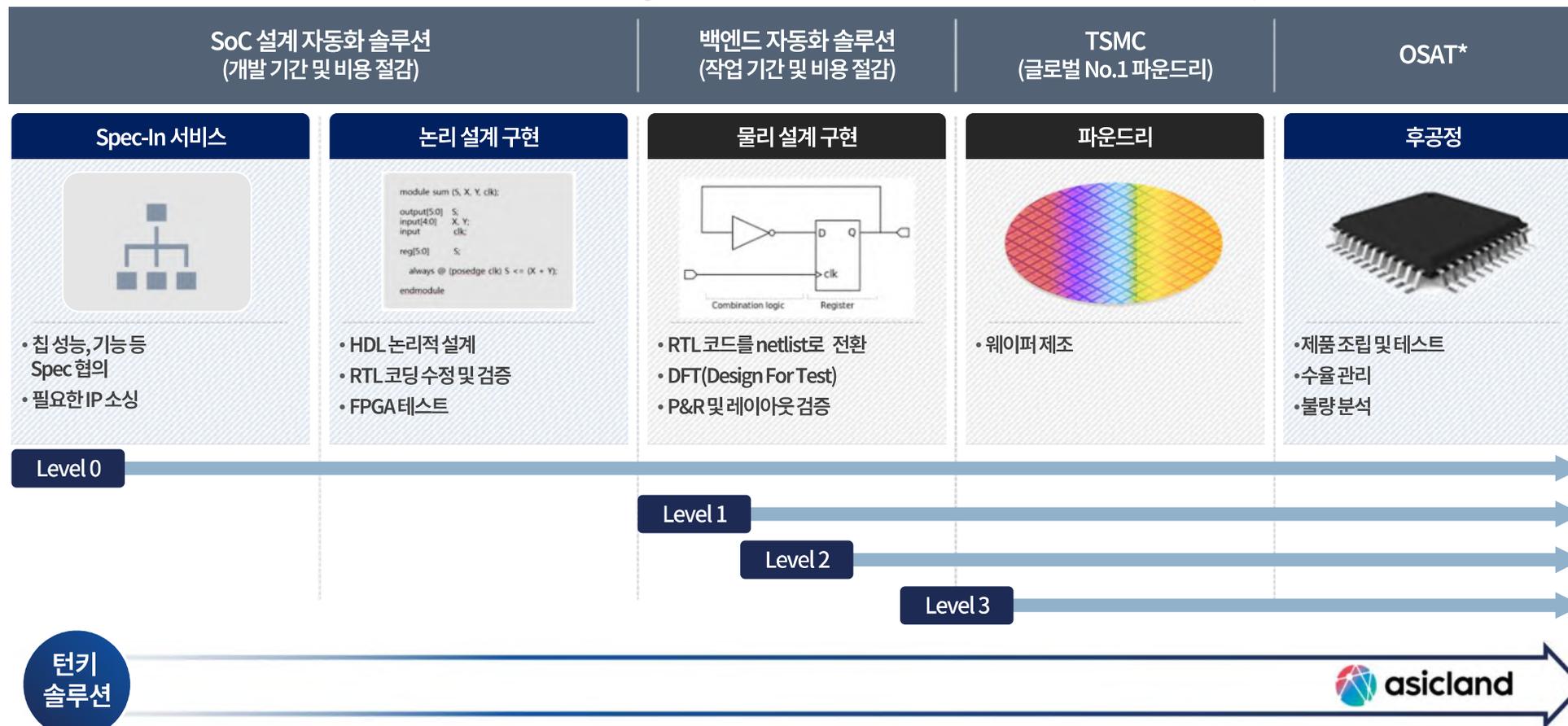
자료 : 전자공시 시스템 감사보고서

03. 비즈니스 영역



통상적인 디자인솔루션과 차별화된 턴키 서비스(설계~공급) 제공

통상적인 디자인솔루션 영역



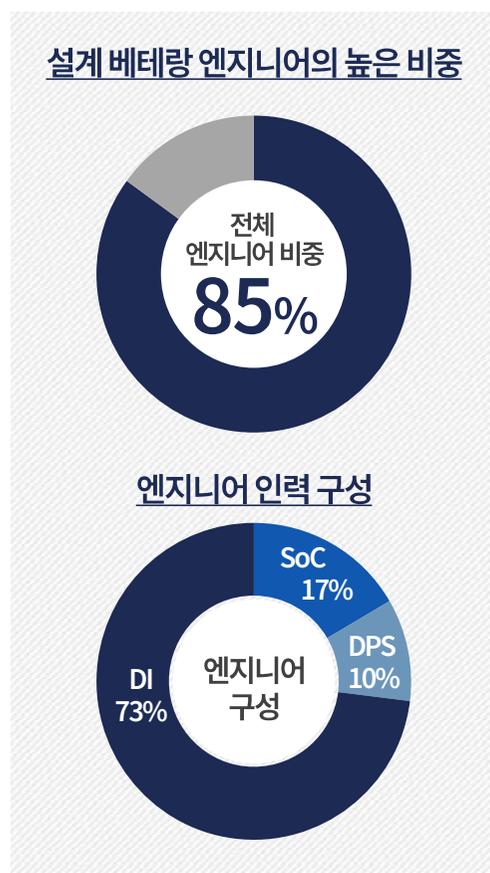
* OSAT: Outsourced Semiconductor Assembly and Test

04. Top Level R&D



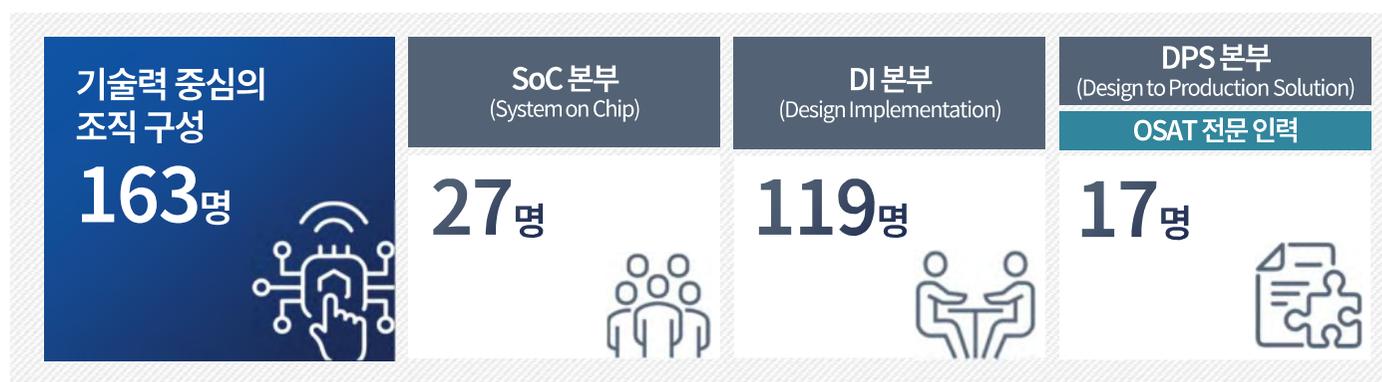
베테랑 설계 엔지니어들의 축적된 노하우와 경험 기반 다양한 고객사 니즈를 충족

엔지니어 현황



자료 : 당사 내부자료 (24년 02월 말 기준)

엔지니어 구성



체계적인 양산 시스템 운영



05. ASIC 설계 자동화 플랫폼 구축



ASIC 설계 자동화 플랫폼 & AI 기반 백엔드 솔루션을 통해 효율성 강화 및 높은 수익성 확보

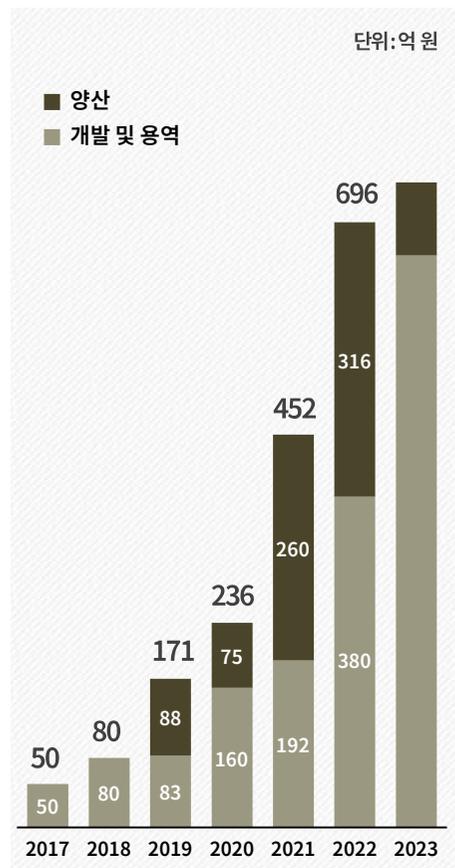


06. 경영성과(1)

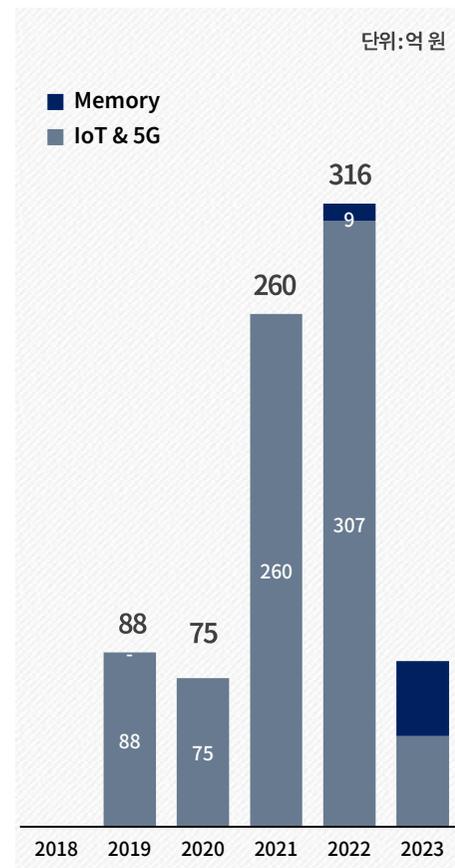


AI 반도체 부문이 빠르게 성장하고 있으며 양산 매출이 증가하는 급속 성장 구간 진입

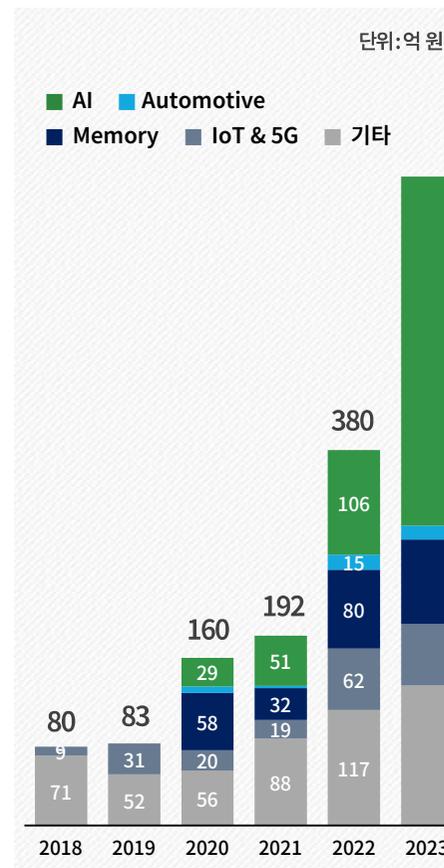
매출유형별 매출액



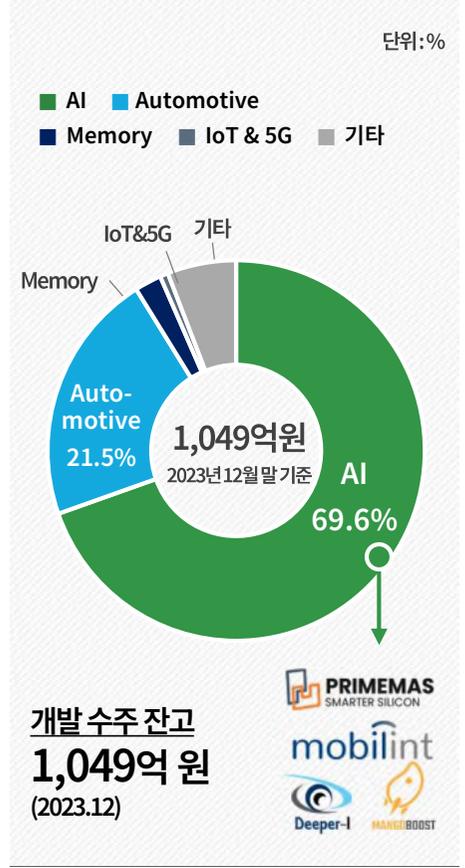
Application별 매출액(양산)



Application별 매출액(개발)



수주잔고



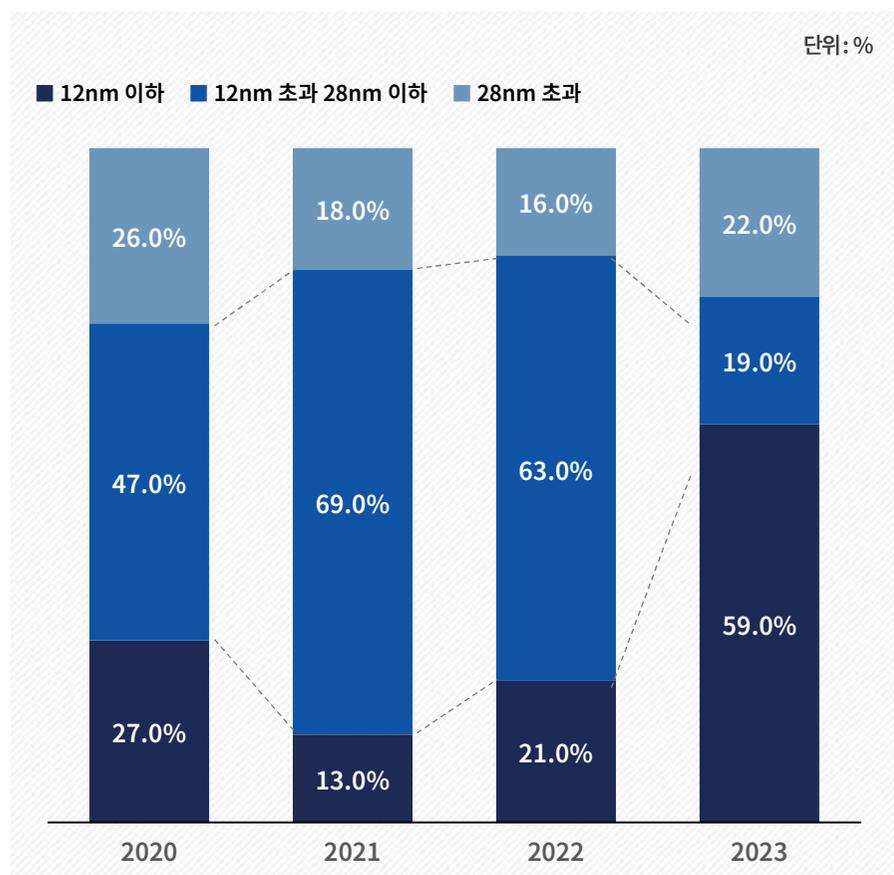
자료 : 연결 기준

06. 경영성과(2)



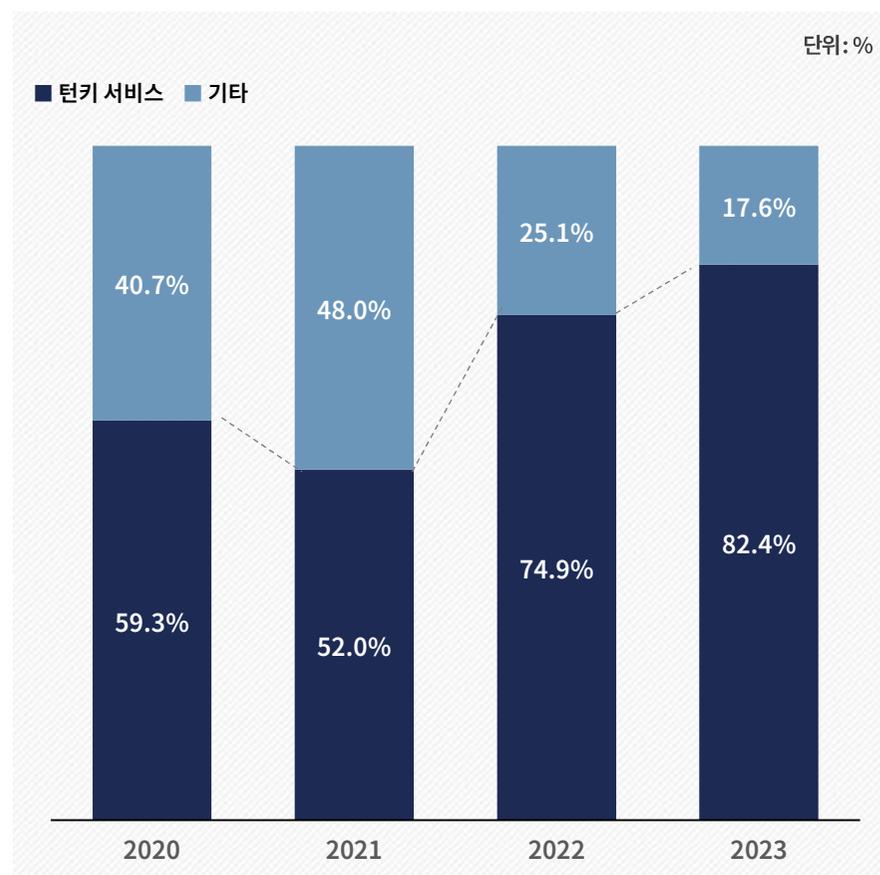
미세공정 및 턴키 프로젝트의 매출 비중이 증가하며 전사 수익성 지속 개선 중

공정별 매출 비중



자료 : 연결 기준

턴키 프로젝트 매출 비중



02 Investment Highlights

01. 강력한 글로벌 메이저 파트너십을 통한 성장성 확보
02. 반도체 전 공정 대응 가능한 국내 유일한 디자인솔루션 기업
03. 4차 산업 시대에 적합한 다양한 어플리케이션과 고객사 확보

Design Service

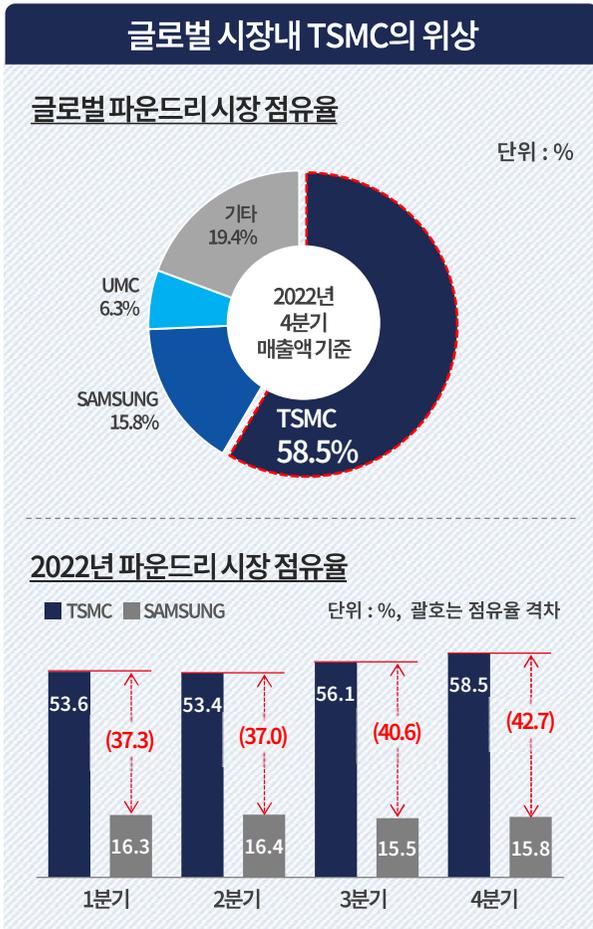
ASICLAND는 고객사가 요청하는 Application에 맞게 합성부터 GDS Out 까지 다양한 공정의 Design Service를 제공합니다.

The background of the slide features a dark blue, glowing circuit board pattern. In the center, the letters 'AI' are prominently displayed in a bright, glowing white font, surrounded by a blue glow that blends into the circuit lines.

01. 강력한 글로벌 메이저 파트너십을 통한 성장성 확보(1)



“고객과 경쟁하지 않는다”- 글로벌 No.1 파운드리 “TSMC”
 파운드리 시장 점유율 60%, 압도적 파운드리 인프라, 30년 업력의 파운드리 NO. 1



자료 :트랜스포스, 업계자료

압도적 No.1 파운드리 인프라 현황

	TSMC	SAMSUNG
공장수	17개 (대만 12개, 해외 5개)	9개 (국내 8개, 해외 1개)
월 생산량	377만 장	100여만 장
공정 범위	3nm ~ 1.0um	3nm ~ 0.18um
핵심 설비 (EUV)	90~100대 (22년)	40~50대 (22년)

TSMC 특징

- 12인치 3nm 공정 부터 6인치 1,000nm 까지 폭넓은 공정 보유
- Package 후공정 시장 선도 (Heterogeneous CoWoS, Hybrid bonding)
- 폭넓은 공정 국내 팹리스 고객 대상 꾸준한 개발 지원
- TSMC MPW 프로젝트 삼성 파운드리 대비 4배 수준
- 양산 제품의 기회 창출
- 투자: 미국, 일본, 독일 등 신규 파운드리 공장 추가
- 고객과 경쟁하지 않음 (Pure 파운드리)

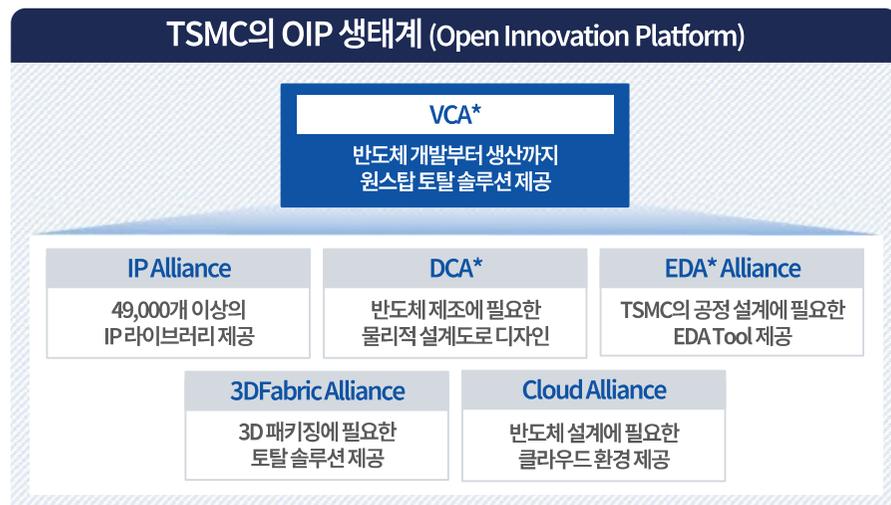
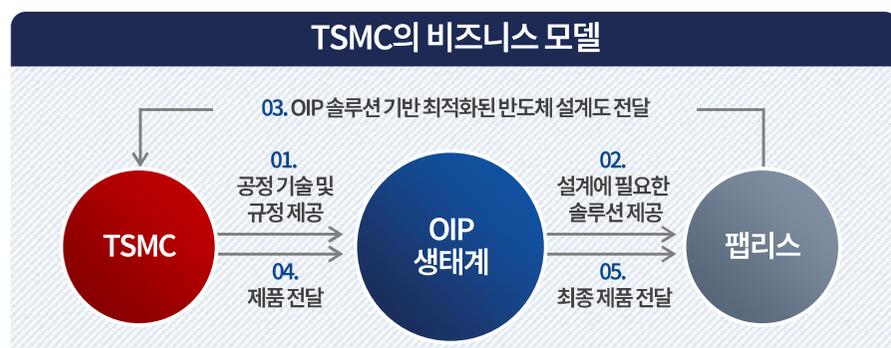


01. 강력한 글로벌 메이저 파트너십을 통한 성장성 확보(2)



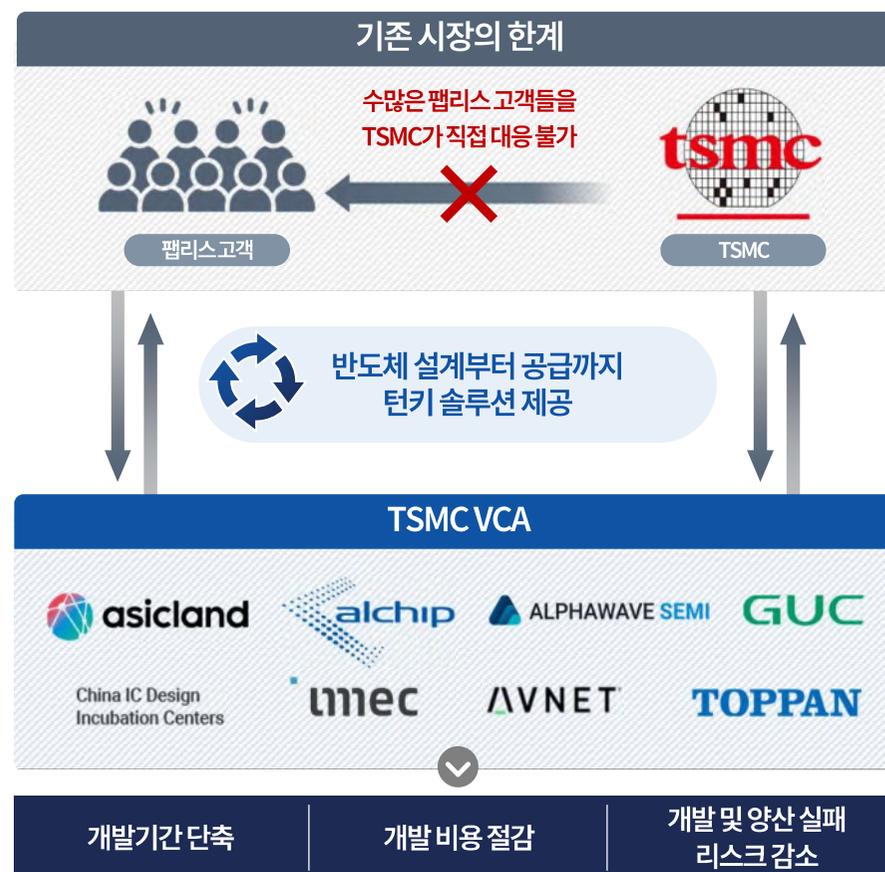
“TSMC VCA”로서 TSMC의 OIP 생태계 내에서 팹리스 고객의 최일선 영업 담당 및 핵심 역할 수행

TSMC의 OIP 생태계 (Open Innovation Platform)



* EDA: Electronic Design Automation
* DCA: Design Center Alliance
* VCA: Value Chain Alliance

TSMC VCA의 역할 (Value Chain Alliance)



02. 반도체 전 공정 대응 가능한 국내 유일한 디자인솔루션 기업



선단부터 레거시 공정까지, 전공정을 아우르는 반도체 생태계 선도 기업 “TSMC”

TSMC의 보유 공정

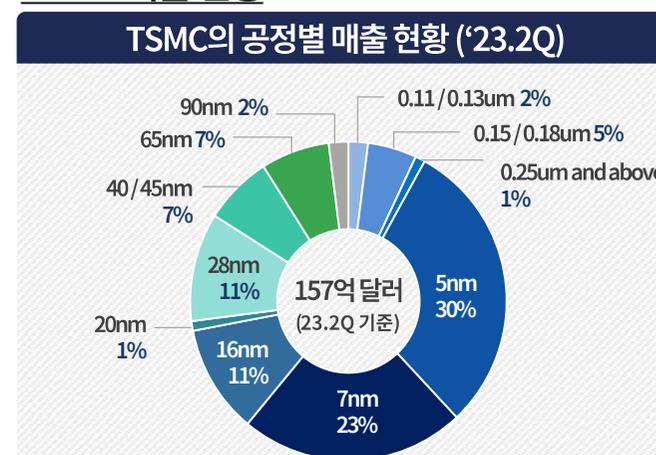


TSMC 보유 공정 ● Available ○ In Development | SAMSUNG 보유 공정 ● Available ○ In Development

TSMC	SAMSUNG	FINGER PRINT SENSOR	MEMS	IMAGE SENSOR	EMBEDDED NYM	RF	LOGIC	ANALOG	HIGH VOLTAGE	BCD-POWER IC
3nm	3nm						○●			
4/5nm	4nm						●●			
7/6nm	7/5nm					○	●●			
10nm	10/8nm					●	●●			
16/12nm	14/11nm				○	●●	●●	○		
20nm	18nm (FD-SOI)					●	●●			
22nm					●	●	●	●		
28nm	28nm (FD-SOI)			○	●●	●●	●●	●	○	
	28nm				●	●	●●			
40nm	45nm			●	●●	●	●●	●	●	●
65/55nm	65/70nm		○	●	●●	●●	●●	●	●●	○
90/80nm	90nm	●	●	●●	●	●●	●●	●	●●	○●
0.13/0.11μm	0.13μm		●	●	●	●●	●●	●	●●	●●
0.18/0.15μm	0.18μm	●	●	●	●	●●	●●	●	●●	●●
0.25μm			●	●	●	●	●	●	●	●
0.35μm			●	●	●	●	●	●	●	●
0.5μm 이상			●	●	●	●	●	●	●	●

자료: TSMC 홈페이지, Cadence

TSMC 매출 현황



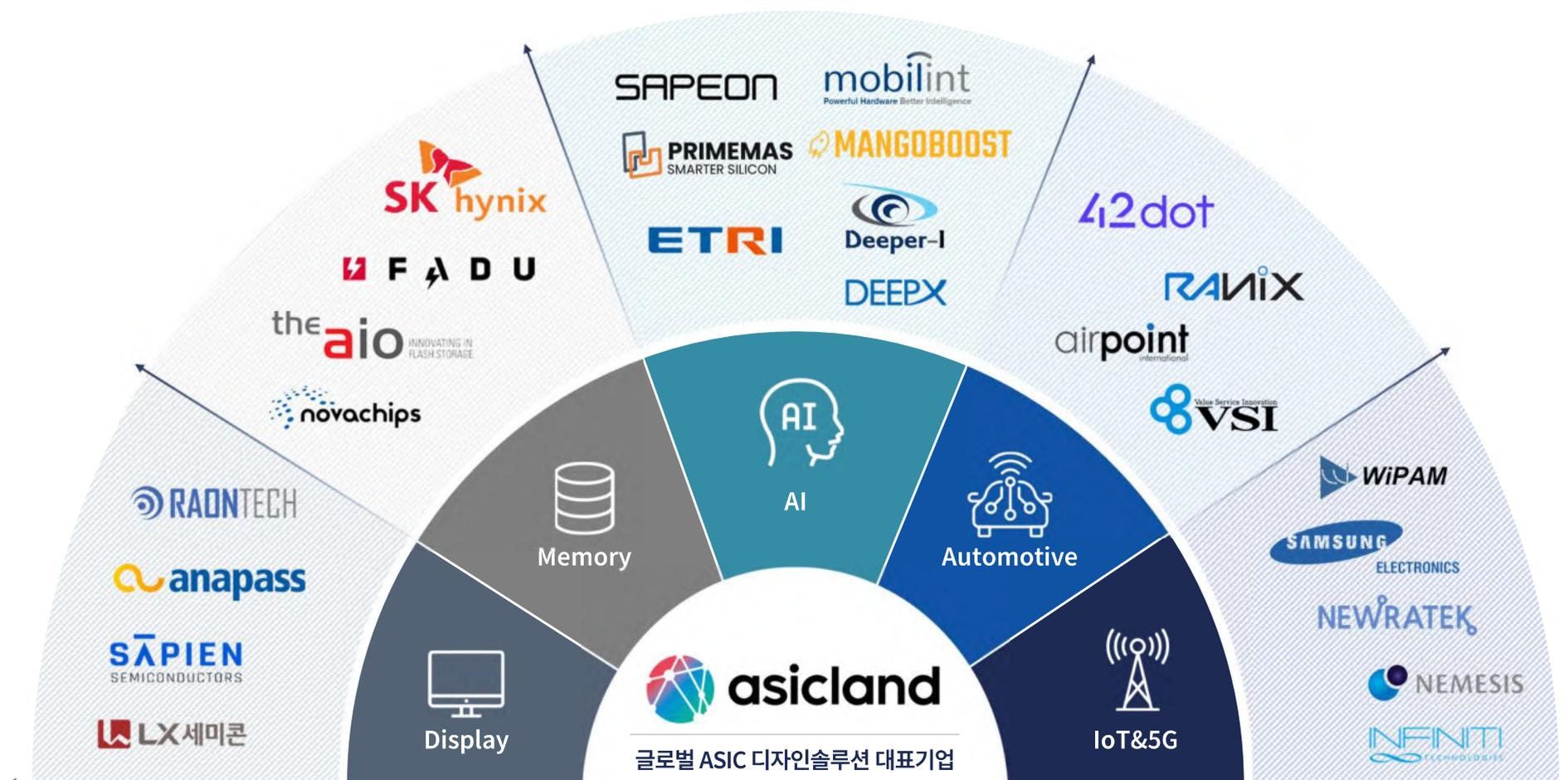
TSMC 고객 지역별 매출 비중

지역	2022연도	2021연도
대만	9.34%	12.8%
미국	66.0%	64.0%
중국	10.8%	10.4%
유럽, 중동, 아프리카	5.5%	5.6%
일본	5.3%	4.5%
그 외	3.2%	2.7%

03. 4차 산업 시대에 적합한 다양한 어플리케이션과 고객사 확보



에이직랜드는 AI, IoT&5G 등 4차 산업 주요 고객에게 디자인 솔루션 전방위 제공
 대기업과 중소기업, 스타트업 등 70여개의 다양한 고객사 확보



자료 : 당사 내부자료, 23년 12월 기준

03

Growth Strategy

01. 성장 로드맵
02. 제품 개발 및 양산 로드맵
03. 신사업 추진을 통한 성장 동력 확보
04. VISION

Product Management Service

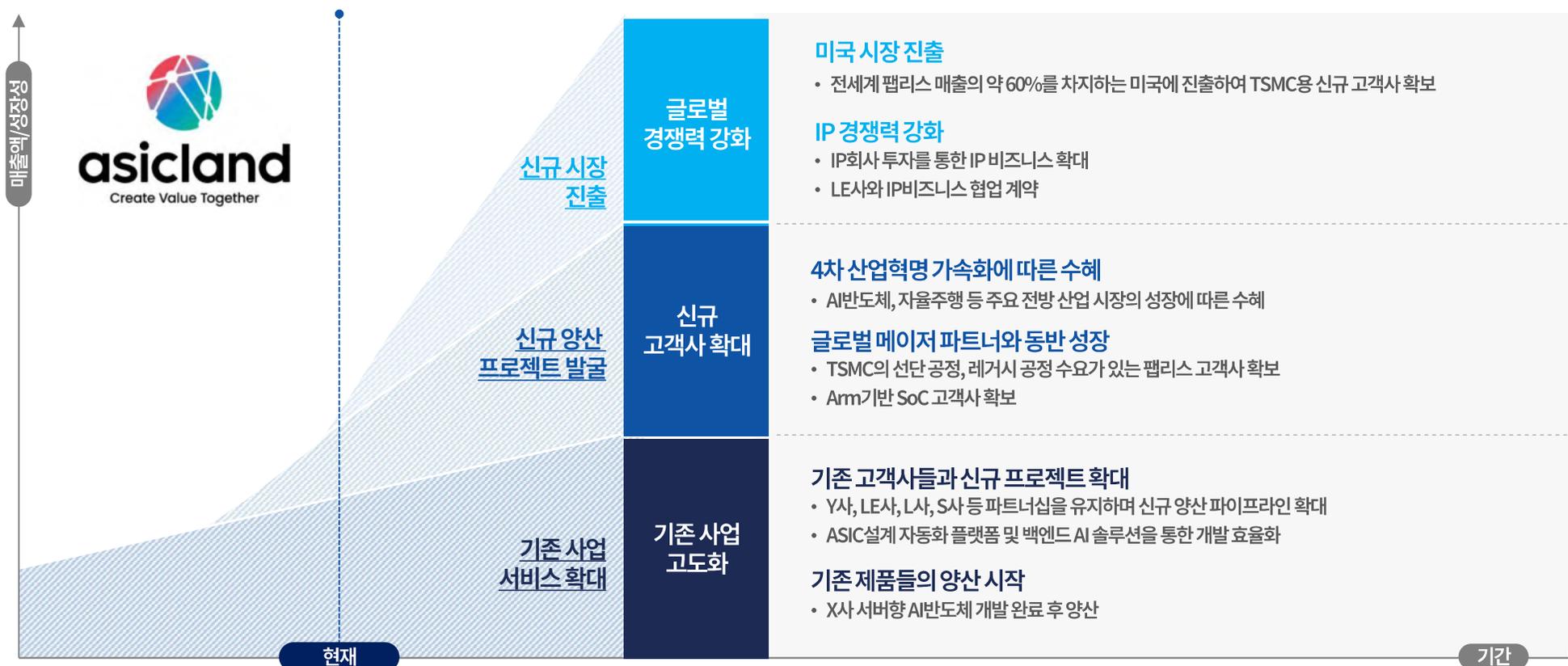
ASICLAND는 고객사의 소중한 제품을 대응하기 위한 Chip 제작의 전체적 Flow Service를 제공합니다.



01. 성장 로드맵



기존 사업 고도화 및 지속 성장을 위한 신규 성장 동력 확보

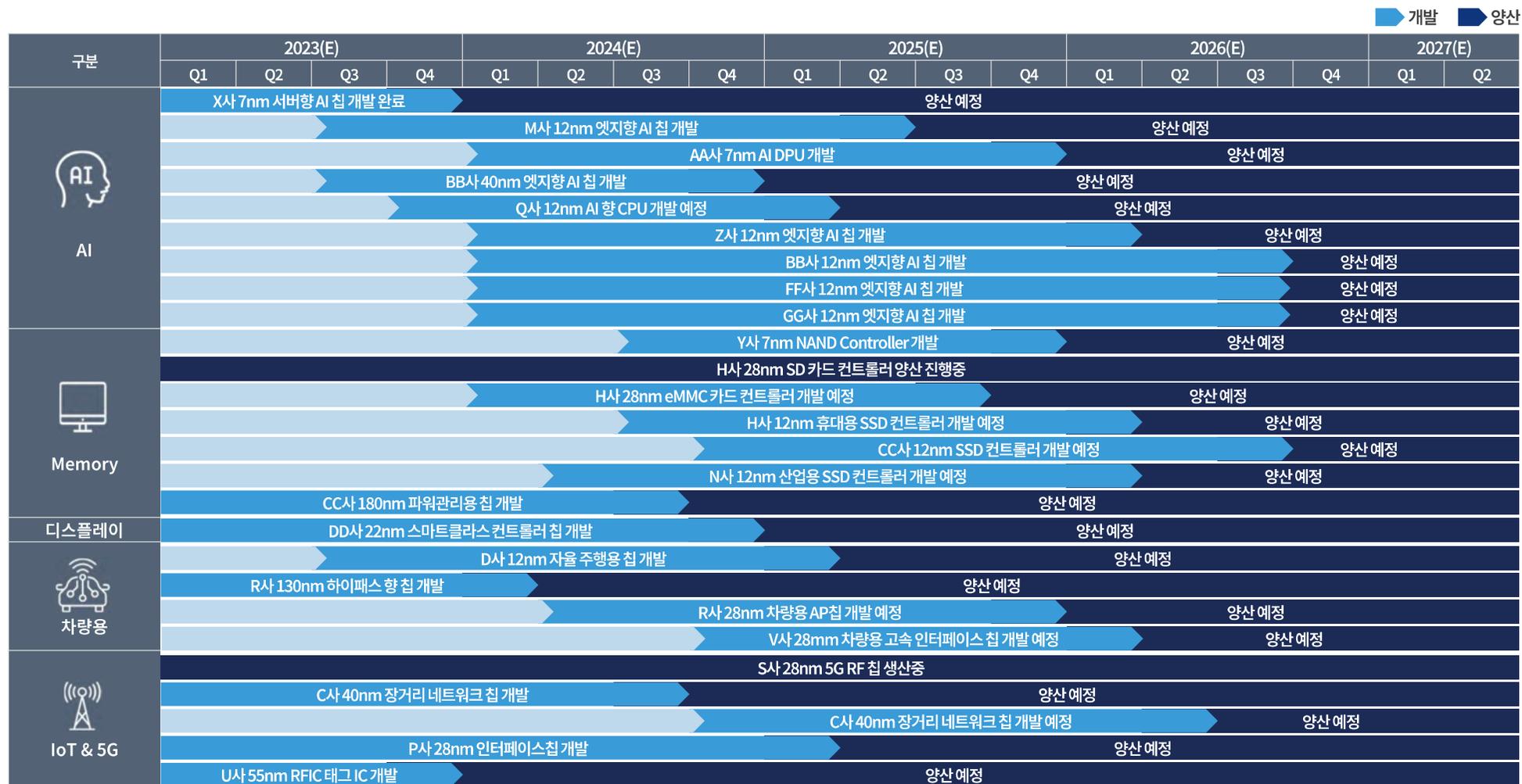


기존 사업 고도화 및 글로벌 진출로 성장 가속화

02. 제품 개발 및 양산 로드맵



4차 산업을 주도할 다양한 응용분야 제품 양산을 통한 미래 성장동력 확보



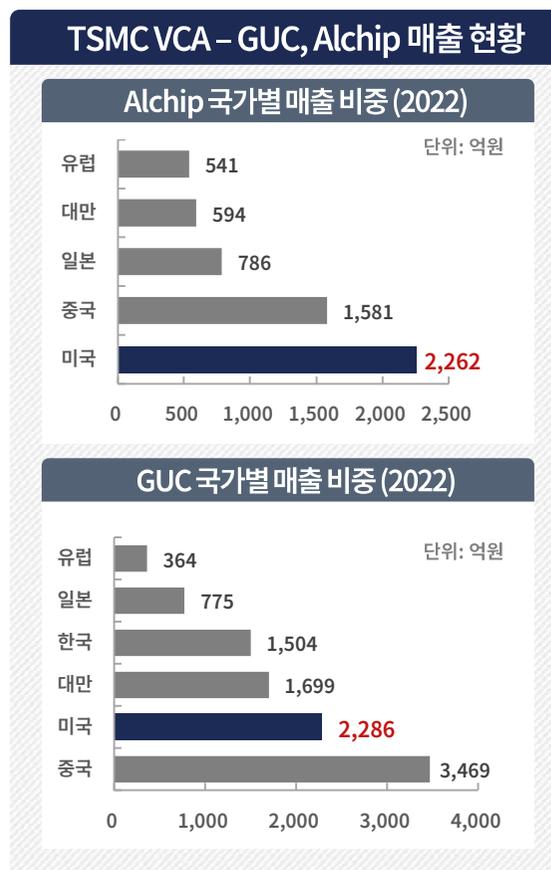
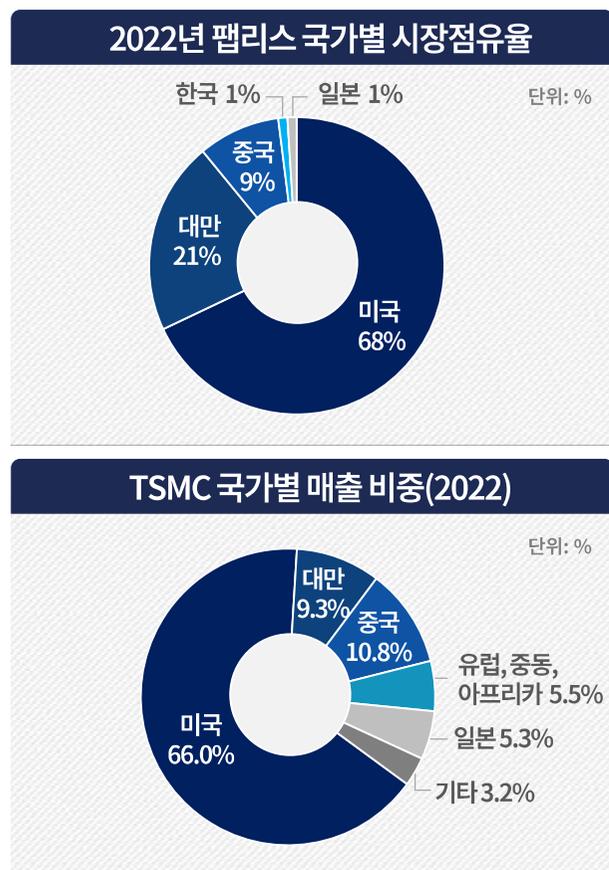
자료 : 당사 내부자료, 2024. 02 기준

03. 신사업 추진을 통한 성장 동력 확보(1)



글로벌 팹리스 시장의 중심, 미국 시장 진출을 통해 성장 가속화

글로벌 팹리스 시장의 중심 미국



자료: 각 사 Annual reports

04. 글로벌 ASIC 디자인 솔루션 대표기업으로 도약



끊임없는 혁신과 글로벌 네트워크로 세계를 선도하는 시스템 반도체 VALUE-UP PARTNER

기존 사업 강화

- 4차 산업 제품 개발 확대
- 기존 고객사와 협업을 통해 파이프라인 확대
- 국내 대기업과의 지속적인 파트너십

신규 성장 동력
+
기존 사업

신사업 진출 가속화

- 미국 시장 진출을 통한 신규 고객사 확보
- IP 비즈니스 확대

글로벌 ASIC 디자인 솔루션 대표기업

글로벌 파트너십 보유

국내 유일 TSMC의 VCA Arm의 ADP

공정에 대한 높은 이해도

높은 공정 이해도로 턴키 서비스 제공
Tape-Out 300여건 이상 수행

우수한 설계 역량 보유

10년 이상의 베테랑 연구원 비중 높음
SoC 설계 자동화 플랫폼

독보적인 레퍼런스 보유

국내 최초 AI반도체 개발
세계 최초 고대역대 5G칩 양산

우량한 경영 성과

연평균 72%의 매출 성장(20~22)
영업 이익 316% 성장(21~22)

Thankyou

